## 認証書付属書(異板厚)

表1 認証試験板厚の溶接条件データ (最小及び最大ルート間隔の場合)

梁フランジ板厚 (mm)	通しダイアフラム 板厚 (mm) 表面段差 (mm)	最小、最大 ルート間隔(mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (cpm)	パス数
1 2×1 9	3.0	4~10テーパ	250~330	29~36	24~30	1
12/13	5.0	1 0	250~330	29~36	24~30	4
$32\times45$	9.0	4~10テーパ	270~360	30~37	19~35	12
32 ^ 4 5	9.0	1 0	270~360	30~37	19~35	12

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲(表面段差 ≦ 2.0mm)

梁フランジ板厚	表面段差	最小 6 mm、最大	溶接電流範囲	溶接電圧範囲	溶接速度範囲	
(mm)	(mm)	ルト間隔(mm)	(A)	(V)	(c p m)	パス数
(11111)	(11111)	4	230~350	25~39	20~40	
9	2.0以下	6	230~350	25~39	15~35	2
	2.05	1 0	230~350	25~39	15~30	
		4	230~350	25~39	20~40	
1 2	2.0以下	6	230~350	25~39	15~35	3
1 2	2.00()	1 0	230~350	25~39	15~30	
		4	240~360	25~41	20~55	4
1 6	2.0以下	6	240~360	25~41	15~50	
		1 0	240~360	25~41	15~40	
		4	240~380	25~41	20~55	5
1 9	2.0以下	6	240~380	25~41	15~50	
		1 0	240~380	25~41	15~40	
	2.0以下	4	240~400	25~42	20~55	5
2 2		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	2.0以下	4	240~400	25~42	20~55	
2 5		6	240~400	25~42	15~50	7
		10	240~400	25~42	15~40	
	2.0以下	4	240~400	25~42	20~55	8
28		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	2.0以下	4	240~400	25~42	20~55	
3 2		6	240~400	25~42	15~50	10
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	2.0以下	4	240~400	25~42	20~55	13
3 6		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
		4	240~400	25~42	20~55	
4 0	2.0以下	6	240~400	25~42	15~50	15
		1 0	240~400	25~42	15~40	

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切上げ)。

- ※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm以下、YGW11:パス間温度 250 $^{\circ}$ C以下、YGW18:パス間温度 350 $^{\circ}$ C以下)で使用しなければならない。
- ※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。
- ※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降

表3 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲 (2.0mm < 表面段差 ≦ 5.0mm)

43	サロルコエルーのシント・イノ	一クかり心足され	// 二十二人	#C[Z] (Z. OHIII <	<b></b>	111111/
梁フランジ板厚	表面段差	最小 6 mm、最大		溶接電圧範囲	溶接速度範囲	パス数
(mm)	(mm)	ルート間隔 (mm)	(A)	(V)	(c p m)	/ // 数
		4	230~350	25~39	20~40	
9	3.0以下	6	230~350	25~39	15~35	3
		1.0	230~350	25~39	15~30	
	3. 0以下	4	230~350	25~39	20~40	4
1 2		6	230~350	25~39	15~35	
		1 0	230~350	25~39	15~30	
		4	240~360	25~41	20~55	5
1 6	5.0以下	6	240~360	25~41	15~50	
		1 0	240~360	25~41	15~40	
		4	240~380	25~41	20~55	5
1 9	5.0以下	6	240~380	25~41	15~50	
		1 0	240~380	25~41	15~40	
	5. 0以下	4	240~400	25~42	20~55	6
2 2		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	5. 0以下	4	240~400	25~42	20~55	
2 5		6	240~400	25~42	15~50	8
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	5.0以下	4	240~400	25~42	20~55	9
2 8		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	5. 0以下	4	240~400	25~42	20~55	11
3 2		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	5. 0以下	4	240~400	25~42	20~55	13
3 6		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
4 0	5. 0以下	4	240~400	25~42	20~55	15
		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切上げ)。

<sup>※</sup> この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11:パス間温度 250℃以下、YGW18:パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

<sup>※</sup> 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。

<sup>※</sup> 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降

表 4 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲 (5.0mm < 表面段差)

	1			I		
梁フランジ板厚	表面段差	最小 6 mm、最大		溶接電圧範囲	溶接速度範囲	パス数
(mm)	(mm)	ルト間隔 (mm)	(A)	(V)	(cpm)	
		4	230~350	25~39	20~40	
9	3.0以下	6	230~350	25~39	15~35	3
		1 0	230~350	25~39	15~30	
	3. 0以下	4	230~350	25~39	20~40	4
1 2		6	230~350	25~39	15~35	
		1 0	230~350	25~39	15~30	
		4	240~360	25~41	20~55	5
1 6	5.0以下	6	240~360	25~41	15~50	
		1 0	240~360	25~41	15~40	
		4	240~380	25~41	20~55	5
1 9	5.0以下	6	240~380	25~41	15~50	
		1 0	240~380	25~41	15~40	
	6.0以下	4	240~400	25~42	20~55	8
2 2		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
		4	240~400	25~42	20~55	
2 5	7.0以下	6	240~400	25~42	15~50	10
		1 0	240~400	25~42	15~40	
		4	240~400	25~42	20~55	
28	8.0以下	6	240~400	25~42	15~50	10
		1 0	240~400	25~42	15~40	
	9.0以下	4	240~400	25~42	20~55	
3 2		6	240~400	25~42	15~50	12
		1 0	240~400	25~42	15~40	]
	10.0以下	4	240~400	25~42	20~55	14
3 6		6	240~400	25~42	15~50	
		1 0	240~400	25~42	15~40	
		4	240~400	25~42	20~55	
4 0	11.0以下	6	240~400	25~42	15~50	16
		1 0	240~400	25~42	15~40	
L	1			l .		·

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める小数点以下は切上げ)。

<sup>※</sup> この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11:パス間温度 250℃以下、YGW18:パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

<sup>※</sup> 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。

<sup>※</sup> 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降